

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-021

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于以实物资产对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》，具体情况如下：

一、增资事项概述

1、本次投资基本情况

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，为落实公司战略发展规划，整合产业资源，增强全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠伦”）的综合竞争力，公司拟以实物资产对重庆惠伦增资人民币2,000万元。此次增资完成后，重庆惠伦的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币22,000万元。

2、投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、被增资方概况

1、增资标的基本信息

公司名称：惠伦晶体（重庆）科技有限公司

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：韩巧云

公司住所：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园

成立日期：2020年06月02日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 电子专用材料研发; 物联网技术研发; 智能控制系统集成; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子元器件制造; 光电子器件制造; 其他电子器件制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 电力电子元器件销售; 光电子器件销售; 住房租赁; 园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、增资前后股权结构

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) |
| 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | 22,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 20,000.00 | 100.00 | 22,000.00 | 100.00 |

3、主要财务数据

单位: 元

| 项目 | 2024年12月31日 (经审计) | 2025年3月31日 (未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,107,331,401.64 | 814,932,524.75 |
| 所有者权益 | 328,896,195.03 | 312,592,566.16 |
| 项目 | 2024年1-12月 (经审计) | 2025年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 246,144,422.94 | 62,147,493.26 |
| 净利润 | -89,730,309.95 | -16,303,628.87 |

三、本次增资的影响和风险

1、公司对重庆惠伦以实物资产方式进行增资, 可整合产业资源, 增强重庆惠伦的综合竞争力, 符合公司发展战略规划和长远利益。

2、本次增资后, 重庆惠伦仍为公司全资子公司, 不会导致公司合并报表范围发生变化, 不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、本次增资后, 重庆惠伦在未来生产经营过程中, 因市场、行业、内部控

制等因素仍可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低相关风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日